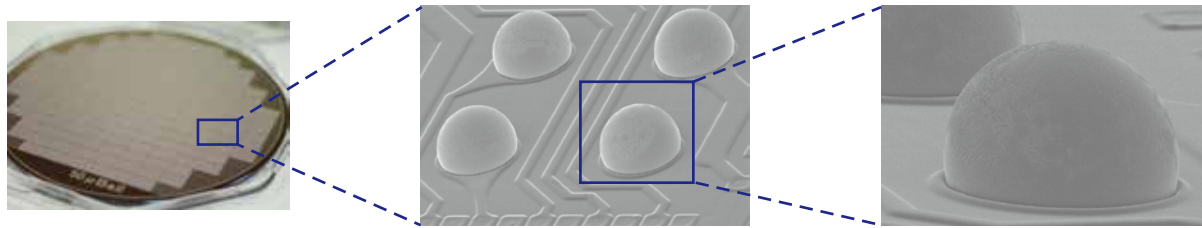


ウェハバンピングサービス

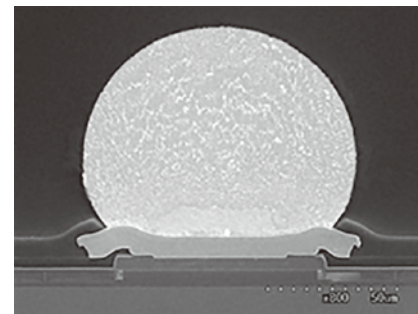
Wafer Bumping Service

自社開発のはんだボール搭載用マスクにより、振込法ではんだボールの一括搭載を優れた歩留率で実現
By using the stencil for solder ball printing we developed, we achieved the batch placement of solder balls on excellent yield rate.



特長 Features

1. はんだボール (Φ50μm以上) 搭載可能
Possible to place 50μm or bigger solder balls
2. UBM形成から受託可能
Possible to support UBM process
3. 高さ均一性に優れるバンパ形成
Excellent high coplanarity solder bumps
4. はんだボール材料の幅広い選択肢
Possible to select various solder materials
5. 各種ウェハ (化合物ウェハ含む) 実績多数
Have much experiences of various wafer including compound wafer
6. 短納期、低コストを実現
Short lead time and low cost
7. はんだバンパ内のボイドを原理的に抑制
Prevent voids in solder bump



はんだバンパの断面画像
Section view of solder bump

仕様 Specifications

		仕様 Specifications		備考 Note
マクセル加工 Maxell process	UBM (構造・方式) UBM (Structure・Method)	① Ti / Cu / Ni (スパッタ&めっき) A) Ti / Cu / Ni (Sputtering & Plating) ② Ni / Au (無電解) B) Ni / Au (Electroless plating)		
	はんだボールサイズ Solder ball size	Φ50μm以上 phi 50μm or bigger		
受け入れウェハ Acceptable wafer	サイズ Size	Φ6インチ (150mm) phi 6-inch (150mm)	Φ8インチ (200mm) phi 8-inch (200mm)	その他は応相談 As for others, asking
	厚さ Thickness	625μm	725μm	その他は応相談 As for others, asking
	電極サイズ Pad size	Φ50μm相当以上 phi 50μm or bigger		
	電極ピッチ Pad pitch	100μm以上 100μm or more		100μm以下は応相談 As for 100μm or less, asking
	電極表面材質 Pad surface materials	Al, Au or Cu		